

Vítejte na O-leaderu

Společnost O-Leading se snaží být vaším partnerem pro řešení na jednom místě v dodavatelském řetězci EMS, včetně návrhu PCB, výroby PCB a montáže PCB (PCBA). Poskytujeme některé z nejpokročilejších technologií PCB, včetně HDI PCB, vícevrstvých PCB, pevných PCB . Můžeme podporovat od rychlého otočení prototypu po střední a hromadnou výrobu.

Naši globální zákazníci jsou obecně našimi službami velmi ohromeni: rychlá odezva, konkurenceschopná cena a závazek v oblasti kvality. Poskytování cennějších technických služeb a celkového řešení je cesta vedoucí k O.

Při pohledu do budoucnosti se O-leader soustředí na inovace a vývoj technologie výroby elektroniky jako vždy a vytrvale usiluje o jednorázovou službu PCB a PCBA s cílem poskytovat prvotřídní služby a vytvářet větší hodnotu pro naše zákazníky.

Popis výrobku

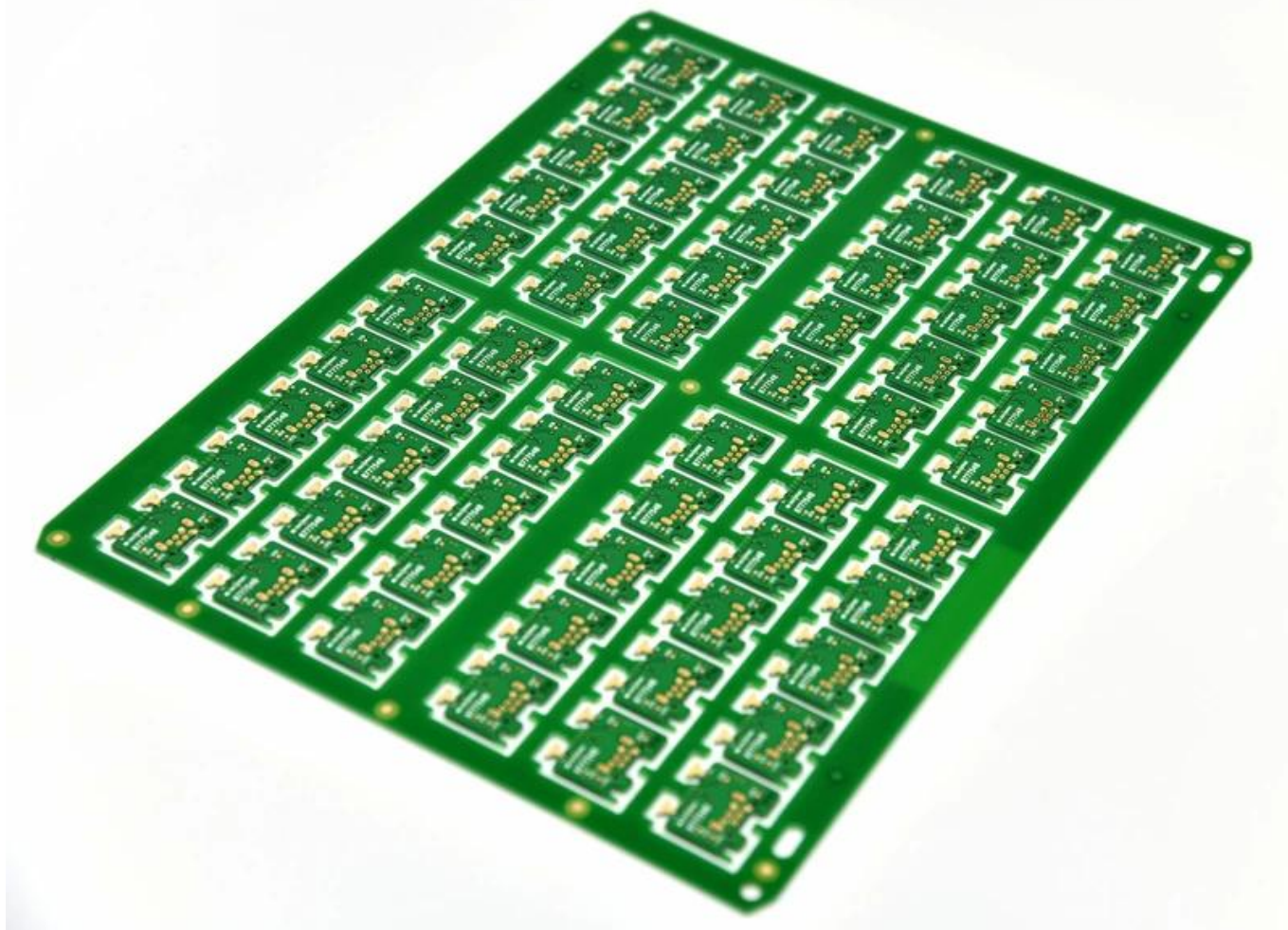
Rychlé informace

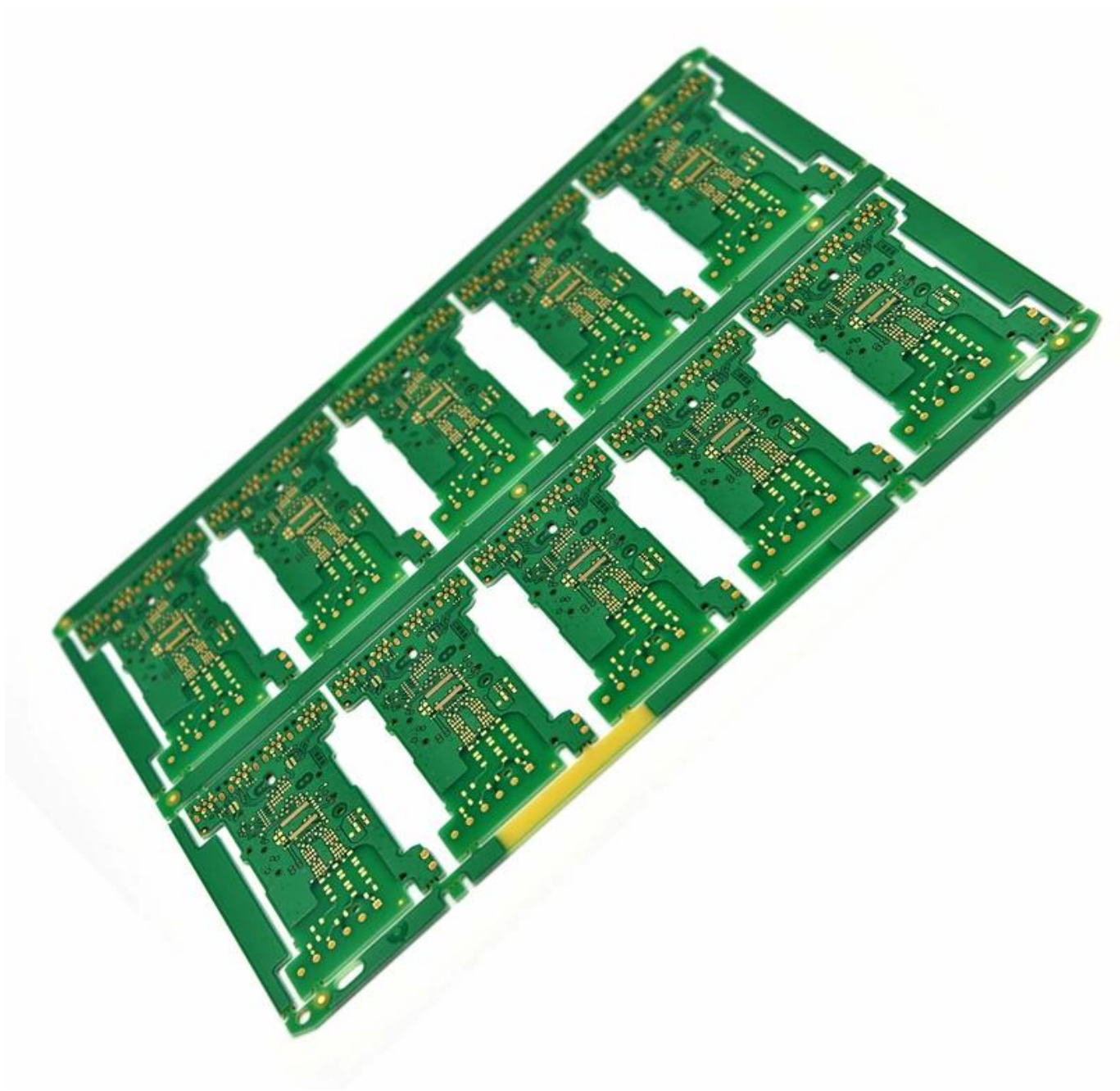
Místo původu	Guang dong, Čína (pevnina)	Jméno značky	O-vedoucí
Základní materiál	FR-4, Hliník	Tloušťka mědi	0,5oz-5oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	0,2 mm
Povrchová úprava	Imerzní zlato, OSP, HASL bez obsahu olova	Tloušťka desky	0,1 - 5 mm
použitelné pro	led, mobilní telefon, klimatizace, pračky	charakter	Průmyslová kontrola pcb
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
hmotnost	0,01 kg -5 kg	MOQ	10ks
Modelové číslo	PowerBank pcb montáž pcha výrobce	Min. Řádkování	0,2 mm
barva	modrá, červená, zelená, černá	cena	0,1-10 \$
tupý typ	požadavek klienta	velikost	0,01 m3 - 10 m3

16 let profesionální výroba desek plošných spojů OEM

položka	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min. Řádek / mezera (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35

Min vrtací otvor průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoli propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění destiček přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. tloušťka jádra (kromě mědi) (μm)	50	40	40	30	40	30
Min. Průměr laserového vrtáku (μm)	75	65	65	50	50	40
Via na pohřben díra / naskládání prostřednictvím	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď atd.					
Vestavěný kondenzátor PCB	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnatý HASL, ENIG, OSP, imerzní stříbro, iminzní cín, Bleskové zlato, Pokovování zlatým prstem, Selektivní pokovování tvrdým zlatem, Odlupovací pájecí maska, uhlíkový inkoust					





[PCB výrobce v Číně](#)

Náš tým



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certifikace





ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max		Max		Meets		C
	Min	Edge			Area	Solder	Oper	Flame	UL796	T	
	mm(in)	mm(in)			Diam	Limits	Temp	Class	DSR	I	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Schopnost procesu

Schopnosti výroby PCB

Počet vrstev: 1Layer-32Layer

Konečná tloušťka mědi □ 1 / 3oz-12oz

Min Šířka / mezera interní internal 3,0 mil / 3,0 mil

Min Šířka / rozteč linek externí: 4,0 mil / 4,0 mil

Maximální poměr stran: 10: 1

Tloušťka desky □ 0,2 mm - 5,0 mm

Maximální velikost panelu (palce): 635 x 1500 mm

Minimální velikost vrtané díry: 4 mil

Tolerance plated Hole: +/- 3mil

Blind / Buried Vias (typy AII): ANO

Prostřednictvím výplně (vodivé, nevodivé): ANO

Základní materiál: FR-4, FR-4high Tg.Halogenový materiál, Rogers, Hliníková základna,Polyimid,

Těžká měď

Povrchové úpravy: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion silver,Immersion Cín, Zlaté prsty, Uhlíkový inkoust

Výrobní schopnosti SMT

Materiál DPS: FR-4, CEM-1, CEM-3, deska na bázi hliníku

Maximální velikost DPS: 510 x 460 mm

Minimální velikost DPS □ 50x50 mm

Tloušťka DPS □ 0,5 mm - 4,5 mm

Tloušťka desky □ 0,5-4 mm

Minimální velikost komponent: 0201

Standardní součást velikosti čipu: 0603 a větší

Maximální výška komponenty □ 15 mm

Min. Stoupání olova: 0,3 mm

Min. Rozteč kuliček BGA: 0,4 mm

Přesnost umístění: +/- 0,03 mm